

1. Модуль паркету, що включає верхній шар та містить на одній з бічних поверхонь елемент з'єднання у вигляді паза, який **відрізняється** тим, що містить додатковий нижній шар, а бічна поверхня, що протилежна поверхні з пазом, додатково містить елемент з'єднання у вигляді шипа, при цьому нижня частина елемента з'єднання паз та верхня частина елемента з'єднання шип виконані із зсувом в протилежні сторони.
2. Модуль паркету за п. 1, який **відрізняється** тим, що елементи з'єднання при з'єднанні між собою окремих модулів паркету щільно прилягають один до одного лише в частині верхнього шару, а в інших частинах виконані з зазором.
3. Модуль паркету за п. 1, який **відрізняється** тим, що товщина верхнього шару паркетного модуля становить в діапазоні від 2 до 8 міліметрів.
4. Модуль паркету за п. 1, який **відрізняється** тим, що товщина нижнього шару паркетного модуля становить в діапазоні від 8 до 20 міліметрів.
5. Модуль паркету за п. 1, який **відрізняється** тим, що виступи нижньої частини елемента з'єднання паз та верхньої частини елемента з'єднання шип виконані в діапазоні від 15 до 30 міліметрів від внутрішньої грані паза та від нижньої грані шипа відповідно.
6. Модуль паркету за п. 5, який **відрізняється** тим, що виступ верхньої частини елемента з'єднання шип менше виступу нижньої частини елемента з'єднання паз на величину зазору.
7. Модуль паркету за п. 1, який **відрізняється** тим, що верхній шар виконаний з дерева.